



2026年5月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ロ ー テ ッ ク
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 賀 賢 漢
 (コード番号：6890 東証スタンダード市場)
 問 合 せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一
 (0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

決算説明資料および中期経営計画（ローリングプラン）資料の開示について

株式会社フェローテック（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日中期経営計画（ローリングプラン）の骨子（目標値等）を別紙のとおり開示いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 主要目標値の推移

(百万円)	26/3 月期		26/12 月期		27/12 月期		28/12 月期
	前回目標値	実績値	前回目標値	今回目標値	前回目標値	今回目標値	今回目標値
売上高	285,000	288,933	340,000	350,000	400,000	400,000	450,000
営業利益	30,000	27,561	35,000	38,000	47,000	48,000	57,000
営業利益率	10.5%	9.5%	10.3%	10.9%	11.8%	12.0%	12.7%
当期純利益	16,000	14,886	20,000	23,000	30,000	30,000	38,000
設備投資	65,000	54,598	45,000	65,000	30,000	55,000	40,000

※当社は、2026年6月26日予定の定時株主総会で承認されることを条件として、2026年度より決算期を12月期に変更（期末日を3月31日から12月31日に変更）する予定であるため、2026年12月期通期業績予想は9ヵ月間（2026年4月1日～2026年12月31日）の予想数値を記載しております。但し、当社の連結子会社は12月決算であり、連結子会社の1月から12月の売上損益が2026年12月期決算に計上されるため、9ヵ月決算となることの売上損益への影響は限定的です。

※26/3月期の目標値につきまして、2025年11月14日開示（中間決算発表時）に営業利益を修正（28,000百万円→30,000百万円）した際、ローリングプランの変更に関する経過開示もしくは業績修正開示において言及が漏れておりましたことをお詫び申し上げます。

2. 目標値設定の背景

- ・外部要因としては、生成AI投資の状況、半導体前工程製造装置（WFE）マーケットの成長および電気自動車（EV）マーケットでの調整と回復期待を反映しております。
- ・内部要因としては、既存工場の稼働率向上や米中半導体摩擦に伴う中国外量産の増強に関する減価償却費および立ち上げコストの増加等を反映しております。

3. 備考

- ・詳細は別紙をご確認ください。
 - ・なお、別紙資料は当社Webサイトにも掲示しております。
- ※発表日時点では日本語のみ掲示。後日、英語版の開示を予定しております。

資料掲示箇所：https://www.ferrotec.co.jp/ir/ir_company_info_session.php

以 上

2026年3月期 決算説明および中期経営計画 骨子

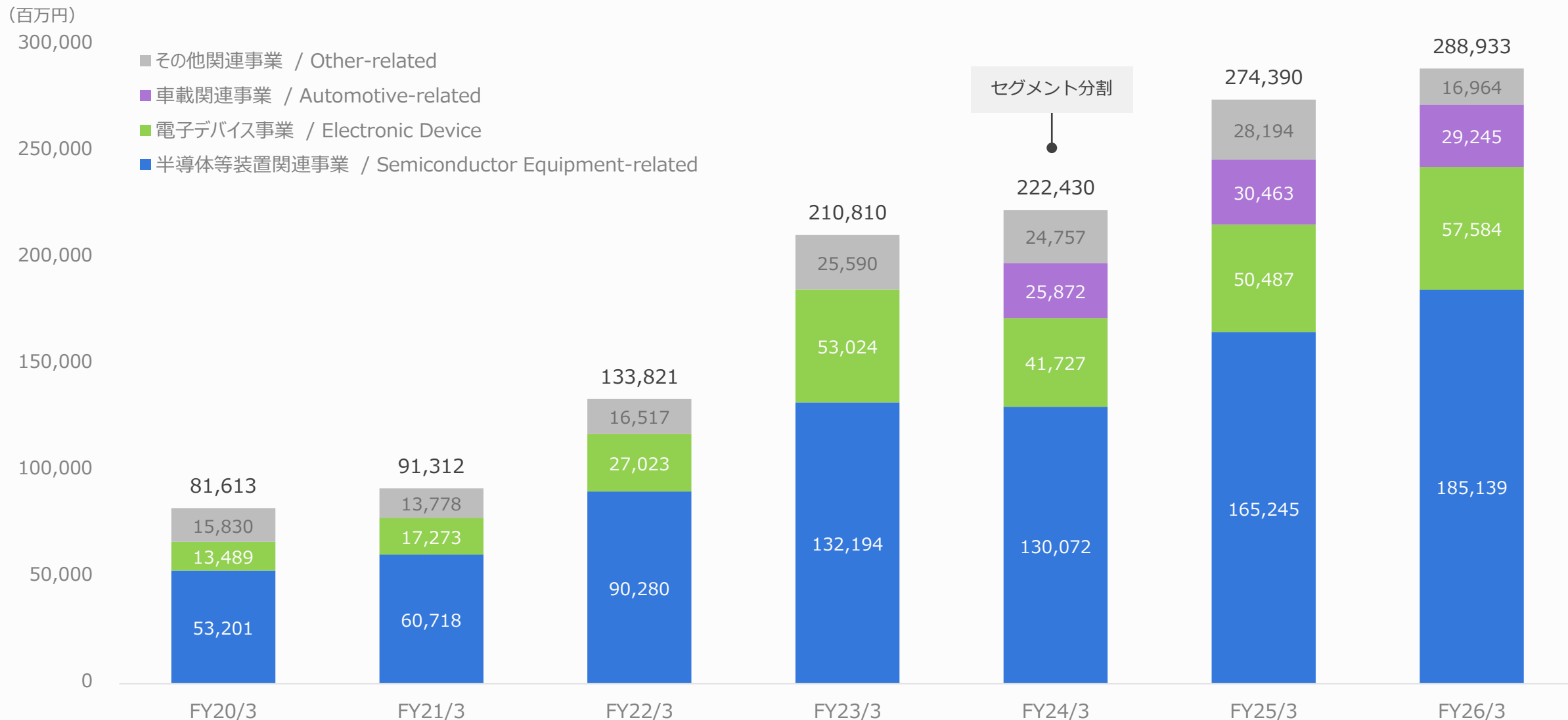
株式会社フェローテック

1. 当期連結決算においては、連結子会社は2025年1月～2025年12月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2026年3月期本決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

Ferro Tec

(百万円)	2026年3月期 Q4		2026年3月期 Q3		QoQ		2025年3月期 Q4		YoY	
	金額		金額		金額	増減率	金額		金額	増減率
売上高	77,287		70,665		6,622	109.4%	72,025		5,262	107.3%
売上原価	57,874		49,541		8,332	116.8%	55,146		2,727	104.9%
売上総利益	19,413		21,123		-1,709	91.9%	16,878		2,534	115.0%
販売管理費	13,691		13,616		74	100.6%	12,485		1,206	109.7%
営業利益	5,721		7,506		-1,784	76.2%	4,393		1,328	130.2%
経常利益	6,426		6,713		-286	95.7%	5,041		1,385	127.5%
非支配株主に帰属する純利益	871		773		97	112.6%	591		280	147.4%
親会社株主に帰属する純利益	4,740		3,837		903	123.5%	3,080		1,660	153.9%
減価償却費	7,490		6,685		805	112.0%	6,376		1,114	117.5%
為替レート (期中平均)		米ドル		147.78				152.24		
		中国元		20.48				21.12		

セグメント別 売上高



業績

- 2026年3月期の売上高は2,889億円、営業利益は274億円、当期純利益145億円
新工場の在庫評価減の増加等あり利益伸び悩み
- 2026年12月通期予想は、売上高3,500億円、営業利益380億円、当期純利益230億円

顧客動向

- AI関連の半導体投資・生産が活発化するなか、米国半導体顧客の中国外生産（Ex-China）ニーズへの対応が進捗、顧客からの引合いおよび増産要請が強い
- 中国半導体の投資・生産の増加、顧客対応進め、金属加工・セラミックス等の引合い増勢
- サーモモジュールは、光通信モジュール向けの引合いが引続き堅調

設備投資

- マレーシア・クリム工場の顧客認定・立ち上げは順調、第二工場（セラミックス、石英、金属加工）は2026年中の稼働予定、需要旺盛で顧客から更なる増産要請あり検討中
- 北京工場（洗浄・金属・セラ）を新設、顧客対応を強化

株主還元他

- 2026年12月期～2028年12月期にかけて、250億円を上限に自己株買いを実施する方針
- 2026年12月期は増配、通期200円/株（普通配当150円、特別配当50円）を予定

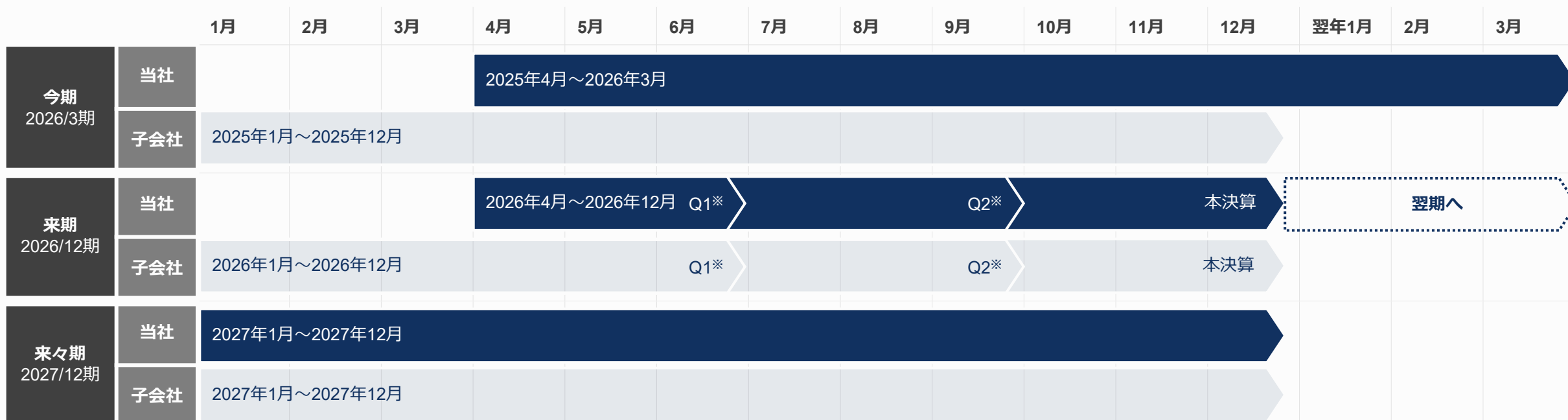
(百万円)	2026年3月期 期末		2026年12月期 期末	
	実績	予想	前年比 (参考値)	
売上高	288,933	350,000	121.1%	
営業利益	27,561	38,000	137.9%	
経常利益	26,063	36,000	138.1%	
親会社株主に帰属する当期純利益	14,886	23,000	154.5%	
設備投資額※	54,598	65,000	119.1%	
減価償却費	27,426	32,172	117.3%	
EBITDA	54,988	70,172	127.6%	
為替レート (期中平均)	米ドル	149.8	150.0	
	中国元	20.87	21.00	

※有形固定資産および無形固定資産の取得額の合計

決算期変更（4-3月→1-12月）

- ▶ 来期より決算期を3月から12月に変更することを、6月26日株主総会の承認を前提に5月15日取締役会で決議しました。
- ▶ 来期は「2026年4～12月」/9か月決算となりますが、当社の連結子会社は12月決算であることから、連結子会社は1月～12月/12カ月の売上損益が計上され、当社単体のみ4月～12月/9か月の売上損益が計上されます。よって、9か月決算となることの連結業績への影響は限定的です。
- ▶ 来々期は 当社および子会社とも「2027年1～12月」/12カ月決算となります。

決算期変更後のスケジュール



※来期の当社Q1決算は2026年4～6月（子会社は同1～6月）、Q2決算は同4～9月（子会社は同1～9月）の実績となる。

▶ 2026年12月期以降の業績予想・計画を上方修正、2028年12月期までのROE・ROIC目標は各15%・8%から引下げ

(百万円)		2026年3月期 実績	2026年12月期 予想	2027年12月期 計画	2028年12月期 計画
業績	売上高	288,933	350,000	400,000	450,000
	営業利益	27,561	38,000	48,000	57,000
	営業利益率	9.5%	10.9%	12.0%	12.7%
	当期純利益	14,886	23,000	30,000	38,000
資本効率	ROE	6.0%	→		11.0%
	ROIC ^{※1}	3.2%	→		7.0%
財務	自己資本比率	38.9%	40.0%	40.0%	40.0%
	設備投資額	54,598	65,000	55,000	40,000
株主還元	1株あたり配当金 ^{※2} (年間)	148.0円	200.0円	DOE (連結株主資本配当率 ^{※2}) を採用、下限を3.5%に設定 自社株式取得を機動的に検討、総還元性向50%を目指す	

※1 親会社帰属純利益/(有利子負債+純資産) 但し純資産は新株予約権、非支配株主持分は除く

※2 連結株主資本=資本金+資本剰余金+利益剰余金-自己株式、連結株主資本配当率=配当金総額÷連結株主資本

▶ 2025年5月30日開示の中期経営計画からローリングアップデート

事業成長

- 半導体関連の需要が増加するなか、日本・欧米顧客の中国外製造（Ex-China）のニーズに対応してマレーシア等の生産を拡充すると共に、中国において顧客対応を強化し、成長を実現する
- 特にAI・データセンター関連事業に注力しつつ、半導体関連、電子デバイス、自動車関連事業を拡大し、成長を追求する

収益性向上 生産効率向上

- マレーシア（クリム、ジョホール）工場の生産拡充・効率性向上による収益率の引き上げ実現
- グループとしてコスト管理・コスト削減のPDCAを推進
- デジタル化・自動化・AI化を展開し、生産効率向上・全面的なコスト削減・競争力強化を追求する
- 各事業の研究センターで新製品・新技術の開発を推進・強化、「品質は命」と考え品質管理徹底を継続

人材強化 企業文化

- 企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」指針の浸透活動を継続する
- 人材重視を重要な経営戦略とし各事業において研修・トレーニングを実施、人材の採用・育成を推進

財務 株主還元

- 株主還元強化のため、DOE採用し下限を3.5%に設定、財務の状況等を考慮しながら自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は50%を目指して充実を図っていく方針（不変）
- 2026年3月期～2027年12月期にかけて、グループ資産売却500億円を想定
- 2026年12月期～2028年12月期にかけて、250億円の自己株買いを実施する方針

トピックス① 半導体関連の需要取り込みへ生産体制を拡充（マレーシア） **FerroTec**

▶ 欧米顧客の中国外生産（Ex-China）ニーズに対応し、マレーシアに大規模な量産拠点を立ち上げ

マレーシア・クリム第1工場

石英・セラミックス・金属加工



- 顧客認定および量産開始、生産量増加が順調に進捗
- 今後、顧客認定と生産量増加が更に進み、収益への貢献が期待できる

マレーシア・クリム第2工場

石英・セラミックス・金属加工



- 6月に起工、8月に建屋工事が竣工予定
- 2026年内に稼働開始見通し

トピックス② 半導体関連の需要取り込みへ生産体制を拡充（中国）

- ▶ 中国半導体市場では、顧客拠点近隣に工場設置することにより顧客対応を強化し、国産化需要の取り込み、中国国内の高付加価値品の販売拡大を図る



北京工場

部品洗浄・金属加工・セラミックス



- 2026年3月に着工し、同12月の建屋完成に向けて進捗
- 2027年6月に操業開始を予定

紹興工場

部品洗浄

パワー半導体用基板



- 2027年夏に操業開始を予定

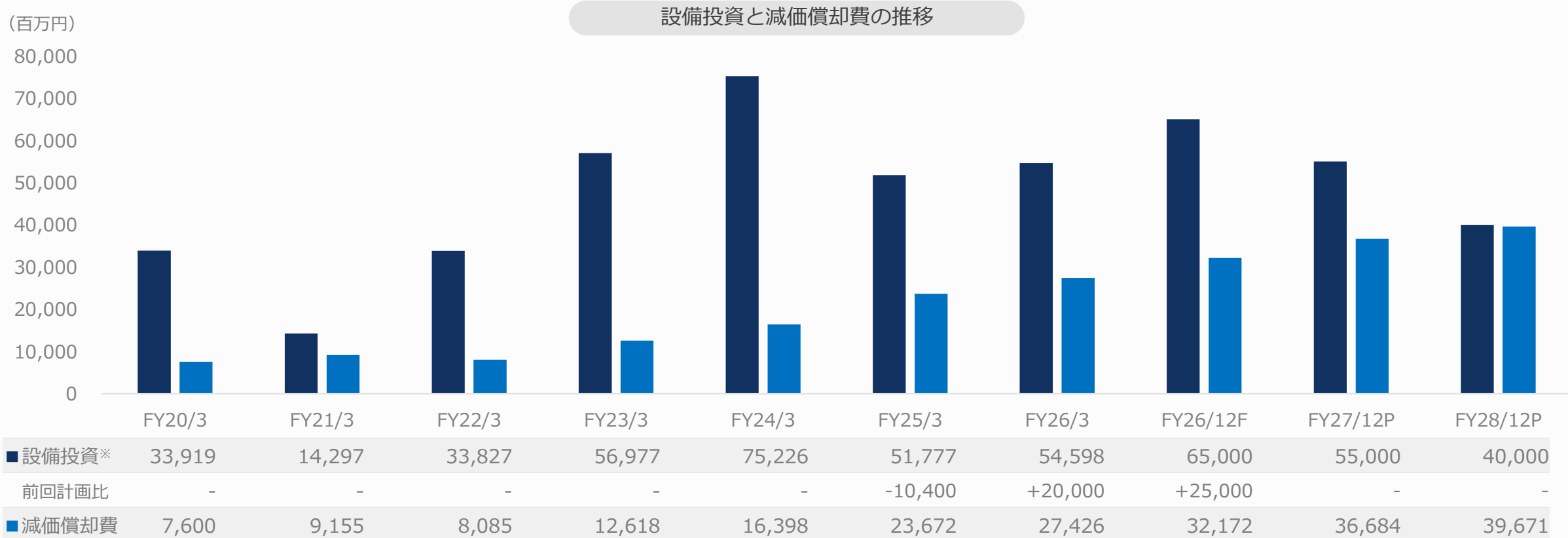
武漢工場

部品洗浄



- 最先端の洗浄ラインを設置
- 2027年夏に操業開始を予定

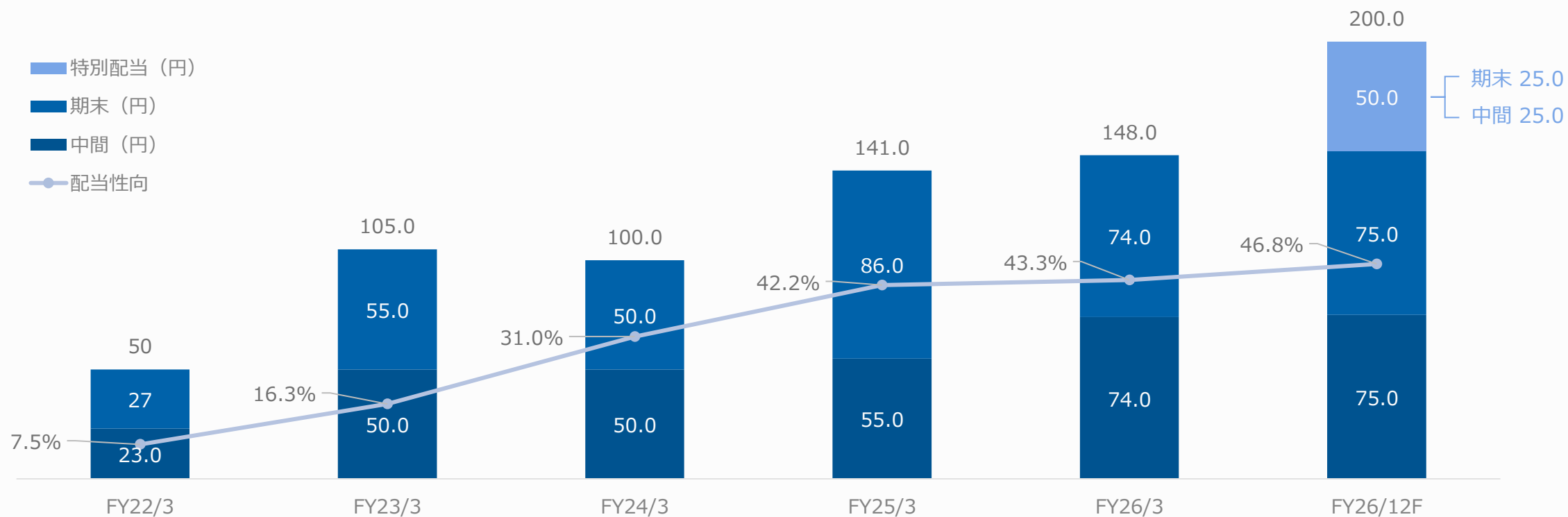
- ▶ 半導体需要の増進および顧客要請を受け、北京工場（洗浄等）の新設に加え、セラミックス等の増産投資、マレーシア工場の追加投資を織り込み、2026年3月期～2027年12月期の設備投資計画は 1,746億円 に増加
- ▶ 2026年3月期～2027年12月期でのグループ資産売却500億円を想定（既存方針から不変）



※有形固定資産および無形固定資産取得額の合計

- ▶ 株主還元強化を図るため、DOEを採用し下限を3.5%に設定、財務の状況を考慮しながら、自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向50%を目指して充実を図っていく（既存方針から不変）
- ▶ 配当金は増配、通期200円/株（普通配当150円＋特別配当50円、配当性向46.8%）を予定
※2026年12月期の中間配当は、配当基準日を9月30日から6月30日に変更し配当を実施する予定です。

1株あたり配当金の推移



半導体等装置関連セグメント



真空シール



金属受託加工



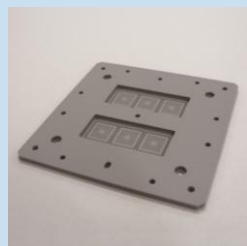
石英製品



シリコンパーツ



ファインセラミックス



マシナブルセラミックス



CVD-SiC



装置部品洗浄



EBガン



石英るつぼ



再生ウエーハ



シリコンウエーハ

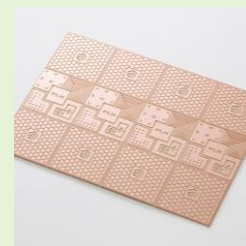
電子デバイスセグメント



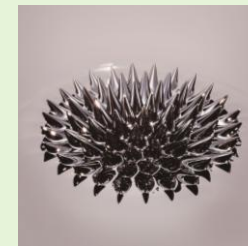
サーモモジュール



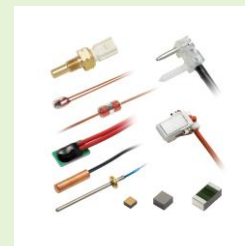
チラー



パワー半導体用基板

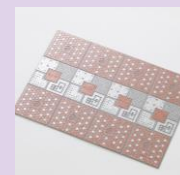


磁性流体



センサ

車載関連セグメント

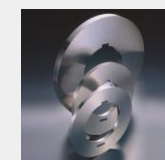


パワー半導体用基板



センサ

その他関連セグメント



工業用刃物、他



フェローテックグループ 拠点一覧



欧州

- 📍 フランクフルト (ドイツ)
- 📍 シュツットガルト (ドイツ)
- 📍 EBガン
- 📍 モスクワ (ロシア)
- サーモモジュール
- 📍 ニジニ・ノヴゴロド (ロシア)
- サーモモジュール

米国

- 📍 ベットフォード
- 真空シール、磁性流体
- 📍 リバモア
- 精密蒸着装置
- 📍 サンノゼ
- 真空装置、真空部品

中国

- 📍 杭州
- サーモモジュール、真空シール、石英、セラミックス、Siパーツ、金属加工、工業用刃物、半導体用ウエーハ
- 📍 上海
- パワー半導体用基板、半導体用ウエーハ、部品洗浄
- 📍 銀川
- 石英坩堝、半導体用インゴット、Siパーツ
- 📍 銅陵
- 部品洗浄、再生ウエーハ、SiCウエーハ
- 📍 東台
- パワー半導体用基板、石英
- 📍 常山
- 石英、サーモモジュール、金属加工
- 📍 麗水
- センサ、半導体用ウエーハ
- 📍 嘉興
- サーモモジュール
- 📍 天津
- 部品洗浄
- 📍 大連
- 部品洗浄
- 📍 広州
- 部品洗浄
- 📍 青島
- 部品洗浄

日本

- 📍 東京 [本社]
- 📍 千葉
- 真空シール、磁性流体
- 📍 石川
- セラミックス
- 📍 岡山
- CVD-SiC
- 📍 山形
- 石英
- 📍 熊本
- 部品洗浄
- 📍 仙台
- 📍 関西
- 📍 熊本

その他 (アジア)

- 📍 クリム (マレーシア)
- 金属加工・組立、石英、セラミックス
- 📍 ジョホール・バル (マレーシア)
- Siパーツ
- 📍 クアラルンプール (マレーシア)
- 📍 シンガポール
- 📍 新竹 (台湾)
- 📍 義王 (韓国)
- 📍 ニューデリー (インド)

工場

営業所

研究所

- ▶ IRポータルサイト「IR STREET」にIRニュースを掲載・メール配信しております
以下のQRコードもしくはリンクより、配信先メールアドレスをご登録いただけます

日本語



[登録ページリンクはこちら](#)

English



[Go to Registration Page](#)

- ▶ 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- ▶ 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額および市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- ▶ 本資料の数値は、百万円単位もしくは億円単位に端数処理をして記載しております。したがって、決算短信や有価証券報告書等の開示書類の数値と完全に一致しない場合がございます。
- ▶ 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- ▶ 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。